



特性

- 》高的热传导率
- 》不含硅氧烷成份
- 》可提供多种厚度
- 》选择高可压缩性, 适合于低压力应用环境

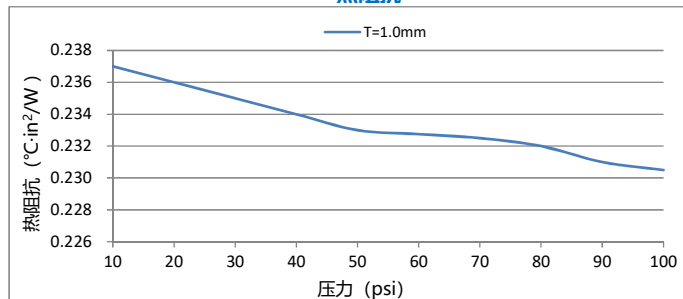
应用

- 》散热器底部或框架
- 》显卡模组
- 》机顶盒
- 》电源与车用蓄电池
- 》LED电视、灯具

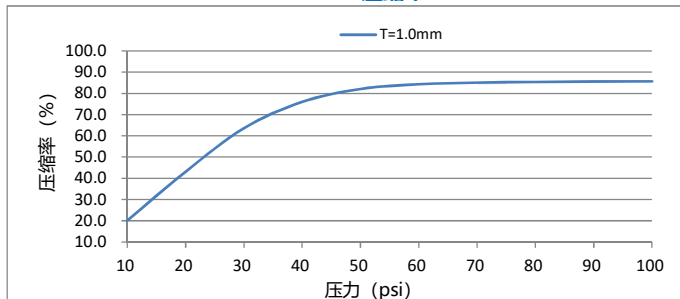
Z-paster®100 6060-11 系列是一种不含硅氧烷成份的导热材料, 可用于填充发热器件和散热片或金属底座二者之间的空气间隙。该款材料柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。其优异的效能使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或散热片上, 从而提高发热电子组件的效率和使用寿命。

Z-paster® 100 6060-11 系列特性表		
产品特性	典型值	测试方法
颜色	深灰色	目视
结构&成份	非硅树脂	-
厚度范围 (inch/mm)	0.040~0.200 1.00~5.00	ASTM D374
硬度 (Shore OO)	60	ASTM D2240
密度 (g/cm ³)	3.3	ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-45 ~ 125	-
击穿电压 (V/mm)	≥5500	ASTM D149
介电常数 @1MHz	9.0	ASTM D150
体积电阻率 (Ohm-cm)	≥1.0×10 ¹²	ASTM D257
导热系数 (W/m·K)	6.0	ASTM D5470
	6.0	ISO22007
阻燃等级	V-0	UL94 (E331100)

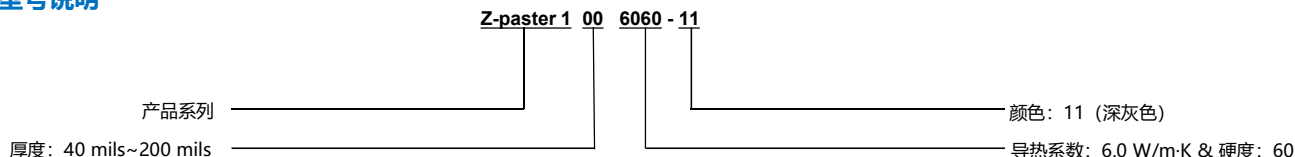
热阻抗



压缩率



产品型号说明



产品规格

标准厚度: 0.040" (1.00 mm) ~ 0.200" (5.00 mm), 以 0.010" (0.25 mm) 为增量。
标准尺寸: 16"×16" (406 mm×406 mm)

Z-paster®系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息, 请与本公司联系。

全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208
 台湾: +886-2-2277-1007
 加拿大: +001-604-2998559
 越南: +84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科科技有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的, 产品规格可能因技术改动或优化而调整, 恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担, Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证, 亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。

